



PRESSEINFORMATION

Februar 2019

AND THE WINNER IS ...

- **Innovative Produkte ausgezeichnet**
- **Erstmal neue Kategorien Embedded Vision und Start-ups prämiert**

Am 26. Februar 2019 wurden traditionsgemäß die embedded awards feierlich vergeben. Die in der Branche begehrte Auszeichnung prämiert zum 15. Mal die innovativsten entwicklungstechnischen Leistungen in den klassischen Kategorien Hardware, Software und Tools. Neu: erstmals wurden auch Preise in den Kategorien Embedded Vision und Start-ups verliehen. Die Preise überreichten Richard Krowoza, Mitglied der Geschäftsleitung der NürnbergMesse und Prof. Dr.-Ing. Axel Sikora, Vorsitzender der Jury und des Fachbeirats der embedded world.

„Wir waren begeistert über die Vielzahl an hochinnovativen Einsendungen der Embedded-System-Entwickler in den verschiedenen Kategorien. Und so hatte die Jury erneut die Qual der Wahl. Wir sehen dies aber als Zeichen dafür, welche Innovationskraft und Dynamik in dieser Branche stecken. Der Preis ist Dank und Anerkennung der embedded world für herausragende Akteure“, so Prof. Dr.-Ing. Axel Sikora.

Ultrahaptics siegt in der Kategorie „Hardware“ mit seinem ultrahaptischen „STRATOS Inspire“-Modul

Mit dem STRATOS Inspire können die Anwender haptische Eindrücke mit den bloßen Händen einfach in der Luft wahrnehmen, ohne wirklich etwas tragen oder greifen zu müssen. Das neue schlanke, autonome Modul ist so gestaltet, dass es rasch und einfach in vorhandene Displays integriert oder mit Location-Based-VR- oder -AR-Anwendungen verknüpft werden kann. Im Inneren des Gehäuses befinden sich mehrere winzige Ultraschall-Lautsprecher, die durch die in zwei zentralen IC (Mikrocontroller und FPGA) integrierten Algorithmen präzise gesteuert werden. Die Algorithmen steuern die zeitliche Abfolge und Frequenz der emittierten Ultraschallimpulse, so dass der durch eine Vielzahl von Ultraschallwellen erzeugte Druck sich an einer Vielzahl von Punkten in Reichweite des Anwenders konzentriert.

Veranstalter Konferenzen
Conference organizer
WEKA FACHMEDIEN GmbH
Richard-Reitzner-Allee 2
85540 Haar b. München, Germany
T +49 89 25556-1349
F +49 89 25556-0349
info@embedded-world.eu
www.embedded-world.eu

Geschäftsführer
CEOs
Kurt Skupin, Wolfgang Materna

Amtsgericht
Registration Number
HRB 119806 München

Veranstalter Fachmesse
Exhibition organizer
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg, Germany
T +49 9 11 86 06-0
F +49 9 11 86 06-82 28
embedded-world@nuernbergmesse.de
www.embedded-world.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Chairman of the Supervisory Board
Albert Füracker, MdL
Bayerischer Staatsminister der
Finanzen und für Heimat
Bavarian State Minister of Finance
and Regional Identity

Geschäftsführer
CEOs
Dr. Roland Fleck, Peter Ottmann

Registriergericht
Registration Number
HRB 761 Nürnberg



Teil der Einheit ist außerdem ein LEAP MOTION®-Kameramodul, das die Handbewegungen des Anwenders mitverfolgt, so dass die haptischen Empfindungen direkt am Handballen oder den Fingerspitzen anliegen können.

Hitex GmbH überzeugt mit AURIX™ SafeTpack in der Kategorie Software

AURIX™ SafeTpack ist ein umfassender Sicherheitsmanager für die zweite Generation der AURIX-Sicherheits-Mikrocontroller von Infineon. Mit ihren weiter verbesserten Funktionen für Konnektivität, Datensicherheit und Funktionssicherheit eignet sich die AURIX-Mikrocontrollerfamilie ideal für ein breites Spektrum unterschiedlicher Anwendungen im Bereich der Kfz-Sicherheit und der Arbeitssicherheit. Diese AURIX-Controller enthalten „Logic Built-In Self-Tests“ (LBIST) als Ergänzung zur Lockstep-Technologie der Kerne. SafeTpack sorgt für die Funktionssicherheit des Mikrocontrollers und steuert dazu die komplexen LBIST sowie weitere Sicherheitsfeatures von AURIX, so dass der Entwickler sich ganz auf die Anwendung konzentrieren kann. SafeTpack bietet darüber hinaus weitere komplexe Safety-Funktionen wie Program Flow Monitoring (um sicherzustellen, dass alle sicherheitsrelevanten Codes ausgeführt wurden) oder die zyklische Steuerung von Peripheriegeräten. Es koordiniert die Ausführung von Anlauf- und Zyklustests, die für den korrekten Betrieb der CPU und der internen Busse sorgen. Außerdem verwaltet SafeTpack das Watchdog-System und einen optionalen kombinierten Watchdog- und Leistungsregler (z.B. TLF3558). Das modulare System von SafeTpack ermöglicht die einfache Anpassung und Ergänzung einzelner Funktionen. SafeTpack kann mit oder ohne AUTOSAR verwendet werden.

GÖPEL electronic GmbH gewinnt mit ChipVORX SI in der Kategorie Tools.

Um den Aufwand für die Designvalidierung und Produktionstests moderner komplexer Baugruppen mit hoher Dichte zu verringern, wurde ChipVORX-SI (Synthetic Instruments) als innovative Technologie für die automatisierte Nutzung vorhandener FPGA als im Design integrierte Testcenter entwickelt. ChipVORX-SI nutzt die nativen Funktionen des FPGA für die Konfiguration so genannter Embedded Instruments und die Durchführung bestimmter Testfunktionen. Diese unter der Bezeichnung ChipVORX IP bekannten Instrumente werden vom Anwender automatisch mithilfe einer Internetschnittstelle unter Verwendung eines Cloud-unterstützten Syntheseprozesses generiert und später vollautomatisch in den FPGA geladen und ausgeführt. Mit ChipVORX SI kann der Anwender komplexe Testinstrumente auch ohne umfangreiches Expertenwissen konfigurieren und diese in seiner Anwendung automatisch einsetzen.

**Die Basler AG erhält für ihren dart BCON for MIPI Development Kit den ersten Preis in der neuen Kategorie „Embedded Vision“**

Das neue Embedded Vision Kit von Basler enthält das erste Kameramodul, in dem der Image Signalprozessor der Snapdragon-SoCs von Qualcomm unter Linux zum Einsatz kommt. Durch dieses innovative Produktkonzept wird die Prozessorlast des Systems erheblich verringert, so dass zusätzliche Rechenleistung für die eigentliche Anwendung frei wird. Der neue Development Kit von Basler umfasst eine komplette Entwicklungsplattform für anspruchsvolle Embedded-Vision-Projekte und vereinigt leistungsstarkes Embedded Processing und CSI-2-Schnittstellentechnologie mit Standards und Funktionsmerkmalen der Machine-Vision-Welt. Der dart BCON for MIPI Development Kit enthält ein dart-Kameramodul (5 MP Auflösung und 60 fps Bildrate) mit BCON for MIPI-Schnittstelle und einem Processing Board mit einem Qualcomm Snapdragon 820 SoC. Durch die sofort einsetzbare Musterinstallation und das Board Support Package einschließlich aller benötigten Treiber ist die Integration genauso bequem wie bei jeder Plug-and-Play-Kameraschnittstelle wie z.B. USB 3.0.

Wisebatt holt sich mit dem Simulationstool für die Optimierung von Elektronikdesigns den Preis in der neuen Kategorie „Startup“

Wisebatt ist ein einzigartiges Simulationstool für Elektronikingenieure, die IoT-Geräte entwickeln. Mit diesem Tool können die Ingenieure virtuelle Prototypen konstruieren und durch enge Kooperation bereits sehr früh im Entwicklungszyklus die unter Kosten-, Batterielebensdauer- und Leistungsgesichtspunkten optimale Lösung erarbeiten. Die Hardwareingenieure können bereits innerhalb kürzester Zeit auf komplexe Modeling-Ergebnisse zugreifen.

Darüber hinaus bietet WISEBATT ein „Freemium“-Geschäftsmodell, mit dem jedermann im Rahmen öffentlicher Projekte Wisebatt kostenlos nutzen kann – ähnlich wie „GitHub“. Dies fördert die Kooperation bei Open-Hardware-Projekten und trägt zur Viralität der Projekte bei.

Die Fachjury 2019 besteht aus:

- Dr. Erich Biermann
Bosch-Automobilelektronik, Robert Bosch GmbH
- Bertold Brackemeier
Senior Manager Public Relations, NürnbergMesse GmbH
- Prof. Dr. Albert Heuberger
Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS



- Joachim Kroll
stv. Chefredakteur Elektronik, WEKA Fachmedien GmbH
- Prof. Dr. Roberto Oboe
Department of Technology and Management of Industrial Systems,
University of Padova
- Prof. Dr.-Ing. Axel Sikora
Offenburg University, Head of jury
- Anne Wendel
Director Machine Vision, VDMA Robotics + Automation

Alle Informationen und Wissenswertes rund um die embedded world 2019 wie Hallenpläne, die ausführlichen Kongressprogramme, das aktuelle Aussteller- und Produktverzeichnis sowie Tipps zur Anreise finden Sie online unter: **www.embedded-world.de**

Folgen Sie uns gerne auch auf Twitter: @embedded_world

Ansprechpartner für Presse und Medien

Bertold Brackemeier, Christina Freund
T +49 9 11 86 06-83 55
F +49 9 11 86 06-12 83 55
christina.freund@nuernbergmesse.de

Alle Aussteller und ihre aktuellen Produktinformationen finden sie unter:
www.embedded-world.de/aussteller-produkte

Alle Presstexte sowie weiterführende Infos, Filme und Fotos finden Sie unter: **www.embedded-world.de/news**